

대 구 대 학 교

■ 주소: (38453) 경북 경산시 진량읍 대구대로 201번지
■ 웹사이트: <https://www.daegu.ac.kr>

I. 산학협력(UIC) 과정

- 산학협력을 통해 맞춤형 교육과정을 운영하고, 취업 연계 지원을 위한 산업체 등 현장 경험을 제공
- 이론과 실무를 겸비한 전문적인 인재 양성 및 순환을 통해 국가 간 교육 교류 추진
- 산학협력 위원회를 통한 교육과정 자문 및 반영
- 반도체트랙 및 부트캠프 운영을 통해 현장성 강화
- 외국인 학생 대상 산업체 연계 프로젝트 및 인턴십 제공
- 글로벌 교육환경 제공: 미국 박사 출신 교수진에 의한 영어 기반 강의 제공
- 졸업 후 국내외 ICT 및 반도체 기업 취업 연계

기초 학습 영역	- 수학, 물리, 컴퓨터프로그래밍, 회로설계 등 이공계 기본 교육
학습 및 실무 체험	- 반도체트랙 및 부트캠프 참여 - 공학설계입문, 전공실무프로젝트, 종합설계 등 실무형 교과목 운영 - 캡스톤디자인, 산학연계 설계 교육 - 산업체 연계 현장실습 운영
비교과 활동	- 55개 이상의 비교과 프로그램 운영 (창의성, 진로개발, 자격증, 외국어 등) - 전문가 특강, 전공역량강화 실습, 진로·취업 컨설팅 제공
연구 및 프로젝트	- 정부지원 연구과제(총 2.7억 규모) 및 특허 기술이전 실적 보유 - ICT와 수학대학의 융합형 산학 프로젝트 추진

- 졸업 후 진로 및 취업 연계
 - 전공 관련 취업을 79.6%, 중소기업 비율 78.4%
 - 반도체 및 ICT 관련 중소·중견기업에 주로 취업
 - 외국인 학생 대상 산업캠퍼스 실습 프로그램 운영 실적 있음
 - 졸업생 네트워크를 활용한 멘토링 및 기업 연계 지속 추진

II. UIC 과정 모집 학과

1. 전자전기공학부 반도체전자공학전공
2. 전자전기공학부 전기공학전공

III. UIC 과정 지원

1. UIC 과정 추가 제출 서류

- 추가 제출 서류 목록
 - 전공 관련 실무·연구 프로젝트 경험이 있는 경우 증빙 제출
 - 어학 능력 증명서 (한국어능력시험 성적, 영어 성적 등)
- 제출 방법
 - 용량이 큰 파일의 경우 이메일 제출 및 지원서상 기재

2. 문의 및 서류발송처

- 담당 부서: 대구대학교 국제처
- 대학 담당자 연락처(문의)

TEL	+82-53-850-5686
FAX	+82-53-850-5699
E-MAIL	shjeon@daegu.ac.kr

- 대학 주소(서류발송처): (우)38453 경상북도 경산시 진량읍 대구대로 201 대구대학교 조형예술대학5호관 국제처 국제팀

3. 지원자 유의 사항

- 외국인 특별전형으로 입학한 학생은 TOPIK 4급 이상을 취득하여야 졸업 가능함
- 전항의 졸업자격을 충족하지 못한 자는 본교 한국어교육센터에서 제공하는 별도의 한국어 어학연수과정 등록 및 수업을 이수하고, 소정의 시험을 통과해야 함

Daegu University

- Address: 201 Daegudaero, Gyeongsan, Gyeongbuk South Korea (ZIP: 38453)
- Website: <https://eng.daegu.ac.kr>

I . Overview of the UIC Program

- UIC Program is will provide University–Industry Cooperation focused curriculum. In addition, the program is to attract and nurture talented scholars in the industry and to be beneficial to individual’s future career.
- This program is designed to promote educational exchange between nations by training and dispatching talented individuals who are equipped with theoretical and practical knowledge.
- Receives curriculum consultation and reflects feedback through the Industry–Academia Advisory Committee
- Enhances hands–on experience through participation in the Semiconductor Track and Bootcamp programs
- Offers foreign students the opportunity to participate in industry–linked projects and internships
- Provides a global learning environment with English–based lectures delivered by faculty members holding Ph.D. degrees from the U.S.
- Facilitates job placement at domestic and overseas enterprises in ICT and semiconductor industries after graduation

Foundational Learning Areas	- Core science and engineering education, including mathematics, physics, computer programming, and circuit design
Academic and Practical Experience	- Participation in the Semiconductor Track and Bootcamp programs - Practical, project-based courses such as Introduction to Engineering Design, Major Project Practicum, and Capstone Design - Industry-linked design education through capstone projects - Field internships in cooperation with industry partners
Extracurricular Activities	- Operation of more than 55 extracurricular programs (creativity, career development, certification, language, etc.) - Special lectures by experts, hands-on skills training, and career/job consulting
Research and	- Holds government-funded research projects totaling

Projects	<p>approximately KRW 270 million and multiple patented technology transfer records</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promotes integrated industry-academia research projects in collaboration with the School of Mathematics and other departments
----------	--

○ Career Pathways and Employment Support

- 79.6% employment rate in major-related fields; 78.4% employment in SMEs
- Graduates are primarily employed in small and medium-sized ICT and semiconductor companies
- Proven record of operating industrial campus internship programs for international students
- Ongoing career mentoring and corporate connections through an active alumni network

II. Departments for UIC Program

1. Semiconductor and Electronic Engineering(Division of Electronic Engineering)
2. Electric Engineering(Division of Electronic Engineering)

III. Admission for UIC Program

1. Additional materials required by each university/department

○ List of required documents

- Proof of practical or research project experience related to the applicant's major (if applicable)
- Language proficiency certificates (e.g., TOPIK score, English test score, etc.)

○ Submission Method

- For large file sizes, please submit via email and indicate the submission in the application form

2. Inquiry and application address

Office	Phone	Fax	E-mail
Office of International Affairs	+82-53-850-5686	+82-53-850-5699	shjeon@daegu.ac.kr

※ Address: Office of International Affairs, Daegu University Daegudae-ro 201, Gyeongsan, Gyeongbuk South Korea (Zip-Code: 38453)

3. Notes

- All international students must achieve TOPIK level 4 or higher in order to graduate.
- Those who could not achieve the above mentioned TOPIK level to graduate must complete DU Korean Language Programs for certain periods of time in order to graduate.